

【パッケージ / Package : SOT-26】

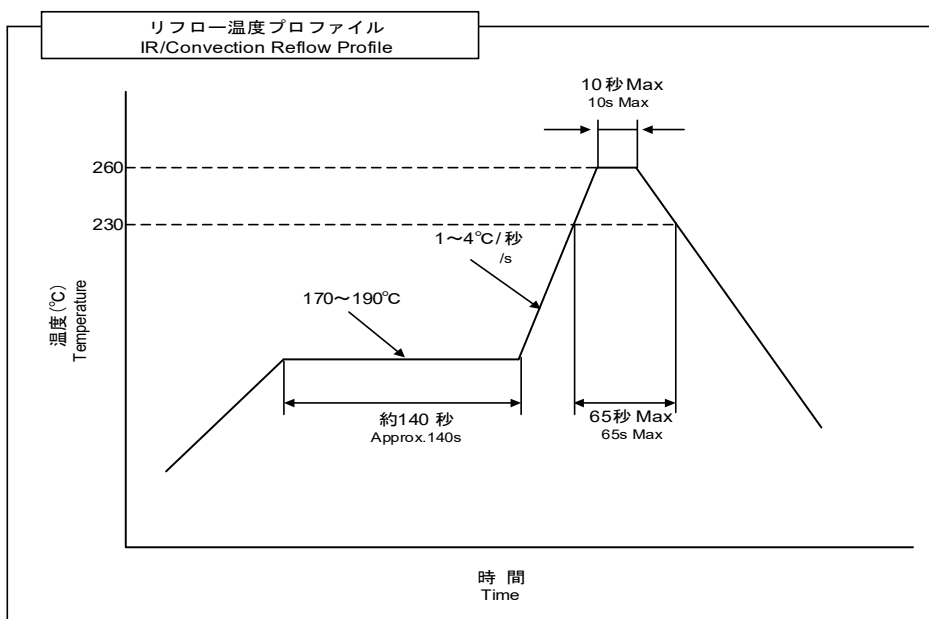
シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow ※	手はんだ Manual ※
XA6130	16	3	可 available	可 available	可 available
XA6131					
XC6130					
XC6131					
XD6130					
XD6131					
XC6132	16	1	可 available	可 available	可 available
XC6133					
XC6134					
XC6351					
XC6412					
XC6415					
XC6416					
XC6419					
XC6420					
XC9401					
XD6132					
XD6133					

【パッケージ / Package : SOT-26】

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)



2) フローはんだ(1回) / Flow soldering (once)

項目 Item	条件 Conditions		備考 Notes
予備加熱 Pre-heat	温度 Temperature	80~150°C	基板表面温度 Surface temperature of P.W.B.
	時間 Time	3分max. 3min max.	
はんだディップ Solder dipping	温度 Temperature	260°C	はんだ槽温度 Temperature of solder
	時間 Time	10秒max. 10s max.	はんだ槽通過時間 Path time

3) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s